

<<电子工艺实习>>

图书基本信息

书名：<<电子工艺实习>>

13位ISBN编号：9787301106990

10位ISBN编号：7301106998

出版时间：2006-5

出版时间：北京大学出版社

作者：周春阳

页数：179

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子工艺实习>>

内容概要

本书是在多年教学实践的基础上，根据电气类、电子信息类和自动化类专业电子工艺实习和电子CAD等课程需要而编写的。

全书内容包括电子元器件、焊接技术、印制电路板的设计与制作、电子产品装配调试、电子产品的整机结构和技术文件、电路设计与制板Protel DXP和电子实习课题共7章，较系统地介绍了电子工艺和电子CAD的基本常识。

本书注重内容的实用性，通俗易懂，有助于读者掌握电子产品生产操作的基本技能，可作为高校培养应用型、技能型、操作型人才的教学用书。

本书可作为高等院校电子信息类、电气类、自动化类专业教材，也可作为电子工程技术人员的参考用书。

书籍目录

第1章电子元器件	1.1 电阻器	1.1.1 概述	1.1.2 电阻器的主要参数	1.1.3 电阻器的标识方法							
	1.1.4 电阻器的测量	1.2 电位器	1.2.1 概述	1.2.2 电位器的主要参数	1.2.3 几种常用的电位器						
	1.2.4 电位器的合理选用	1.2.5 电位器的质量判别方法	1.3 电容器	1.3.1 概述	1.3.2 电容器的主要技术参数						
	1.3.3 电容器的命名和标识方法	1.3.4 几种常见的电容器	1.3.5 电容器的合理选用和质量判断	1.4 电感器	1.4.1 电感线圈	1.4.2 变压器					
	1.5 开关和接插元件	1.5.1 开关	1.5.2 接插件	1.5.3 选用开关和接插件应注意的问题	1.6 半导体分立器件	1.6.1 常用半导体分立器件的分类	1.6.2 半导体器件的命名方法	1.6.3 晶体二极管	1.6.4 晶体三极管	1.6.5 场效应晶体管	1.6.6 晶闸管
	1.7 集成电路	1.7.1 集成电路的分类	1.7.2 集成电路应用须知	1.7.3 型号命名与识别方法	1.8 表面安装元器件	1.8.1 表面安装元器件的特点和分类	1.8.2 片状电阻器	1.8.3 片状电容器	1.8.4 片状矩形电感器	1.8.5 表面安装半导体器件	
	1.9 传感器	1.9.1 概述	1.9.2 热敏电阻器	1.9.3 压敏电阻器	1.9.4 光敏器件	1.9.5 热释电红外传感器	1.9.6 霍耳传感器	1.10 LED数码管和LCD液晶显示器	1.10.1 LED数码管	1.10.2 液晶显示器	
	1.11 本章小结	第2章 焊接技术	第3章 印制电路板的设计与制作	第4章 电子产品装配调试	第5章 电子产品的整机结构和技术文件	第6章 电路设计与制板Protel DXP	第7章 电子实习课题参考文献				

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>